

Intelligent Automation Leader

| 智能自動化的領導者



MIRLE 盟立集團

法人說明會 Investor Conference

免責聲明 Disclaimer

- 簡報內本簡報及同時發佈之相關訊息，包括公司策略、財務狀況等內容，係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。
 - 本簡報所作有關本公司財務上、業務上、Q&A之說明，可能與未來實際結果存有差異。其原因可能來自各種因素，包括但不限於市場需求、各種政策法令與整體經濟現況之改變，及其他本公司無法掌控之風險等因素。
 - 本公司不因任何新事件或任何狀況的產生而負有更新或修正本簡報資料內容之責任。
-
- The information contained in this presentation and its accompanying announcements, including content relating to business outlooks, financial operations, is based on information derived from internal corporate data and external economic developments as a whole.
 - The company's finance, business and Q&A made in this presentation could be different from the future actual results. This may be due to various factors, including but not limited to market demands, changes in policies and regulations and overall economic conditions, and other factors or risks beyond the Company's control.
 - The Company is not responsible for updating or amending changes or adjustments made to the contents of this presentation, if such changes or adjustments should occur in the future.

簡報目錄 | CONTENTS

01

公司簡介(Company Profile)

02

經營績效 (Operation Performance)

03

營運展望(Business Outlook)

04

Q&A

01

公司簡介Company Profile



Intelligent Automation Leader

關於盟立集團 (About Mirle)

MIRLE 盟立集團



盟立創立迄今三十六年，持續致力於以穩定可靠的整廠自動化能力，大幅提升企業客戶的競爭力。盟立精準剖析市場狀況與客戶需求，滾動式調整營運策略，抓準產業與科技快速發展的趨勢，大舉投資與開發人工智慧、戰情系統、雲端運算、大數據、數位孿生等新技術領域，以智能科技建構全面且符合效益的方案，滿足客戶整廠自動化的需求。

約21億

資本額

36年

深耕產業

10,000+

實績案例



董事長兼總裁

Signature



人形機器人
機器狗



半導體



智能物流

主要客戶產業

- 半導體
- 汽機車
- 食品業
- 機械加工業
- FPD
- 觸控面板
- 電腦 / 資訊及相關產業

股票代碼: 2464

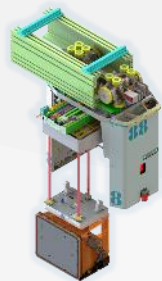
- 成立日期：1989年2月2日
- 集團總部：新竹科學園區研發二路3號
- 台灣據點：臺北分公司/銅鑼廠/后科廠/南科廠
- 中國大陸據點：上海總部/昆山/深圳
- 海外據點：泰國/馬來西亞/越南

盟立合作夥伴與客戶

超過36年自動化專業實力，引領100,000+企業智造未來



MIRLE 半導體 AMHS Total Solution



OHT

空中走行式無人搬運車



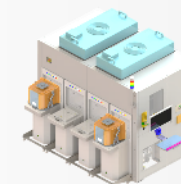
Tower STK

跨樓層 搬送系統



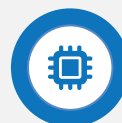
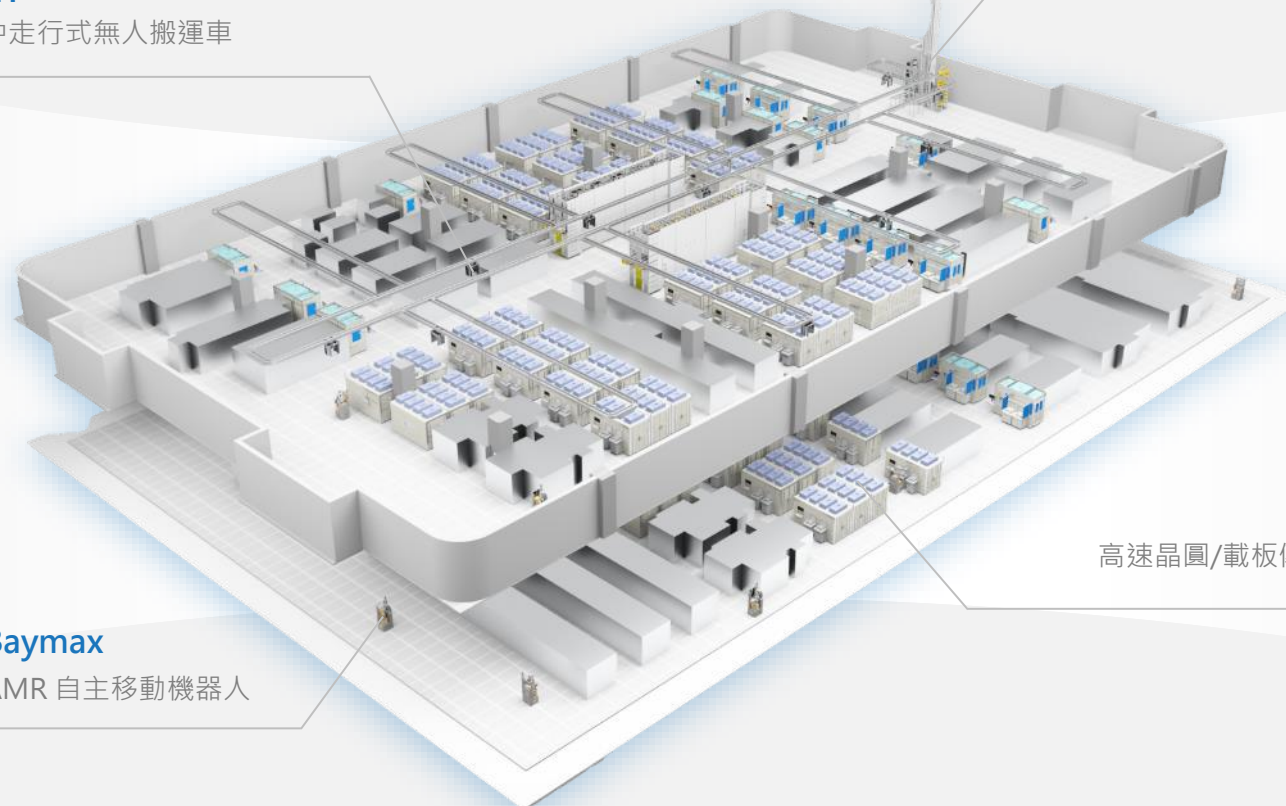
Baymax

AMR 自主移動機器人



EFEM

高速晶圓/載板傳送設備



半導體場域



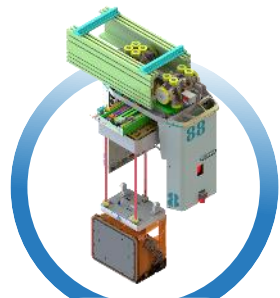
FOPLP場域



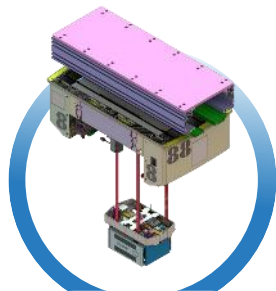
ABF載板場域

半導體 AMHS自動物料搬送系統

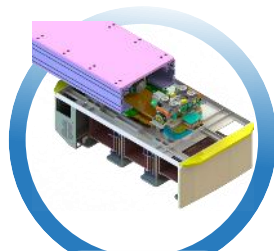
空中走行式無人搬運車



OHT



M-OHT

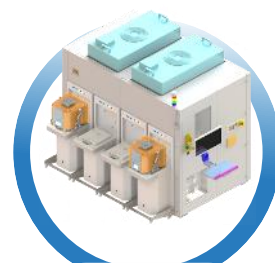


OHS

高速晶圓/載板傳送設備



PLP EFEM



EFEM

晶圓暫存設備

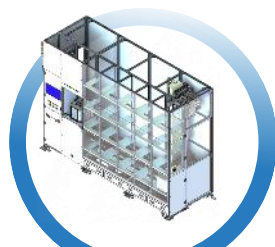


NTB

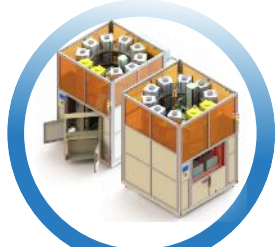


LBS

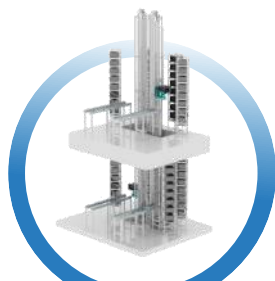
Stocker 潔淨室儲存及傳送設備



STK



ZIP STK



Tower STK

AMR 自主移動機器人

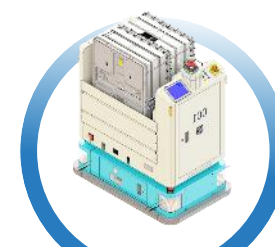


Baymax



MR AGV

AGV 無人搬運車



FP AGV



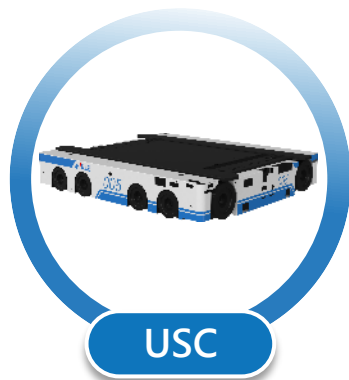
Frame AGV

MIRLE 智能物流 AMHS Total Solution



智能物流 AMHS自動倉儲系統

穿梭式自動倉儲系統



USC



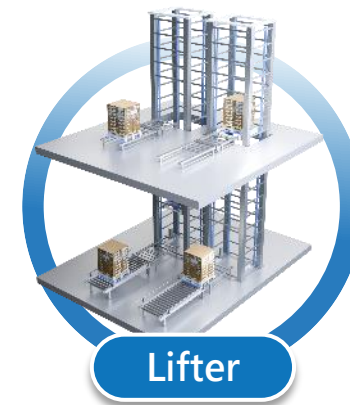
MSC

無人搬運車系統



AGV

高速垂直搬送系統



Lifter

自動倉儲系統

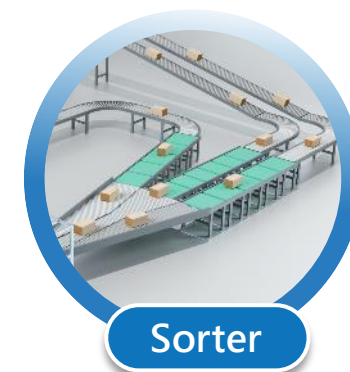


Miniload



Unitload

高速智能分揀系統

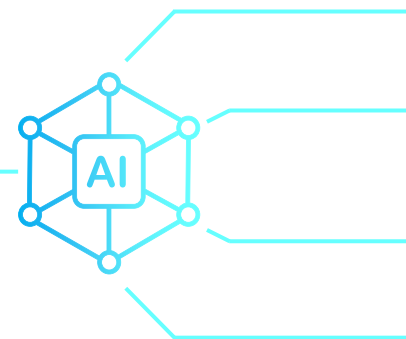


Sorter

人形機器人/機器狗及場域應用



Digital Twin



關節馬達



感測器



導航



夾爪

定義規格及性能

因應客戶場域的特殊需求，掌握Digital Twin 及AI大腦模型技術規格，開發人形機器人/機器狗。

願景

建立場域應用「隨插即用」(Plug and Play)的介面，讓AI大腦與所有硬體無縫溝通。這將是台灣從傳統成本思維轉向價值思維的關鍵。

02

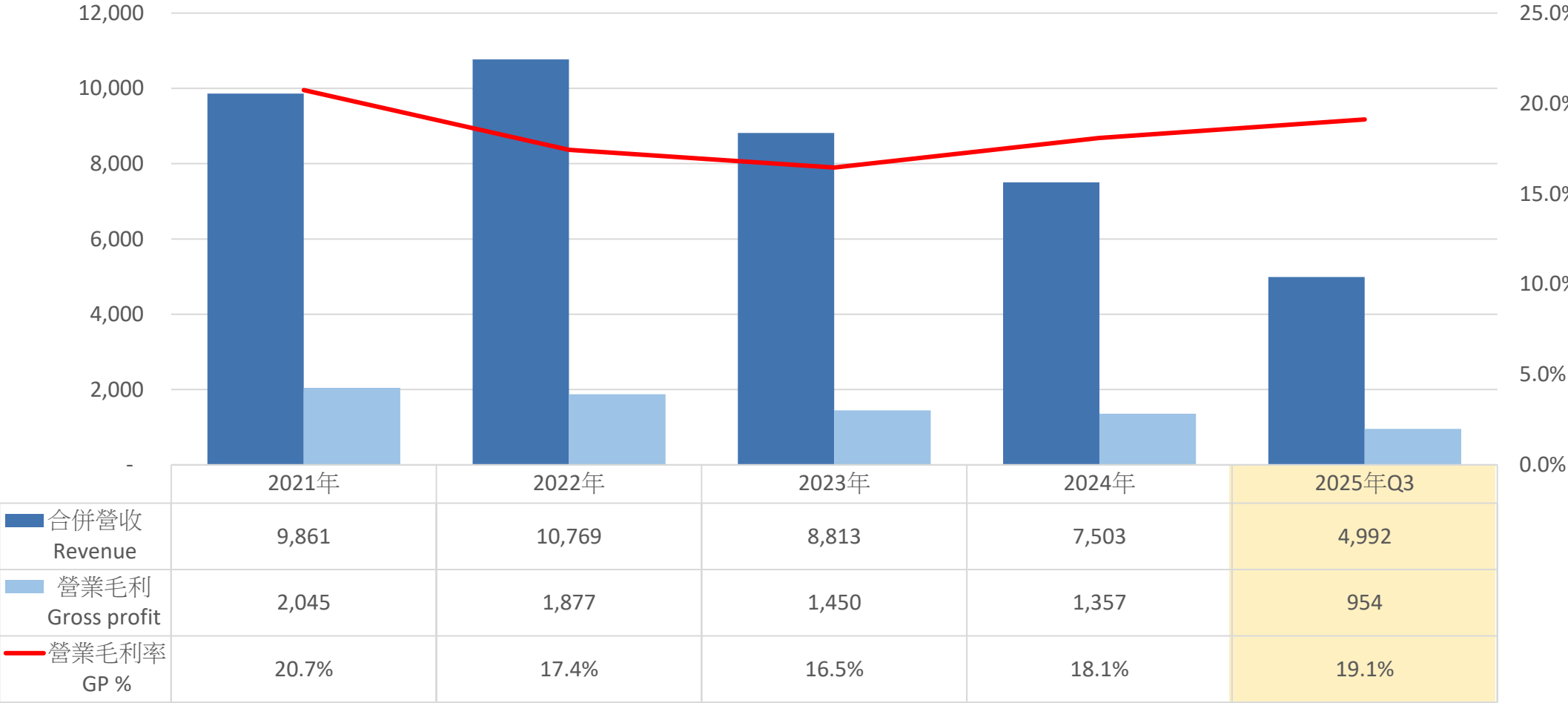
經營績效Operation Performance



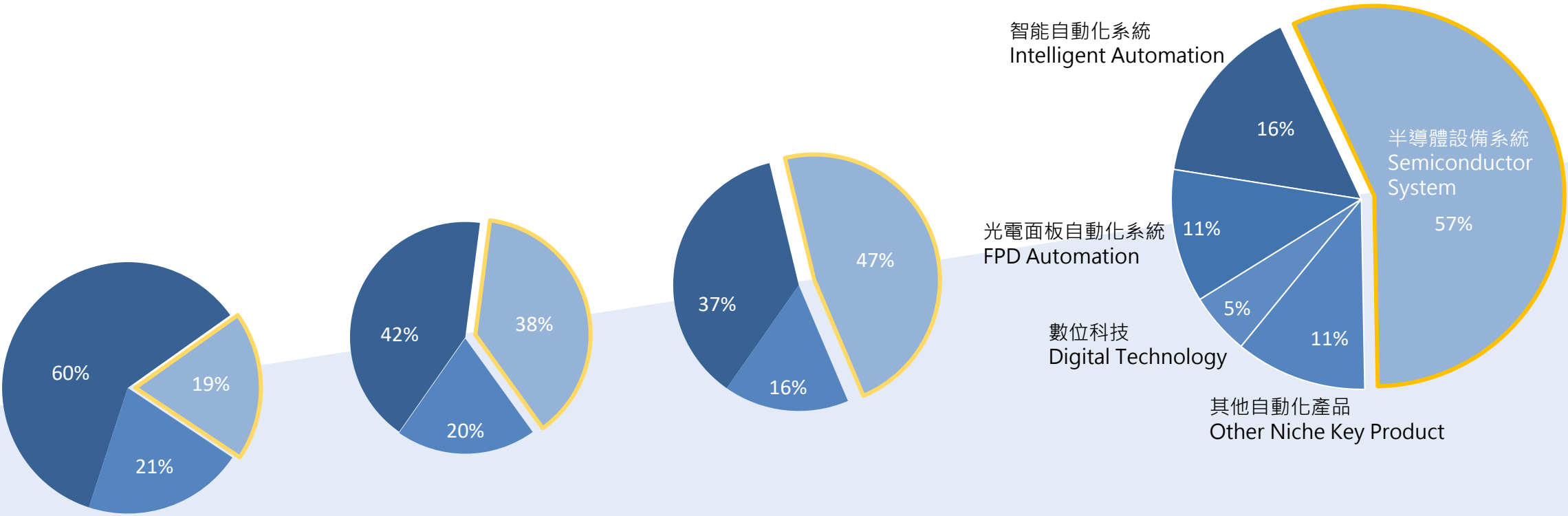
| Intelligent Automation Leader

年營收及毛利 Revenue & Gross Profit by Year

單位:佰萬元 ; %
Unit : In Millions of NTD · %



年度產品別營收 Revenue by Product Category



2022年

- 光電面板及智能自動化物流仍為營運主力(60%)
- 已跨入半導體後段製程及相關供應鏈並建立實績(19%)

2023年

- 半導體設備系統逐漸成為主要營收動能(38%)
- 光電面板為主之自動化系統營收佔比逐年下降(42%)

2024年

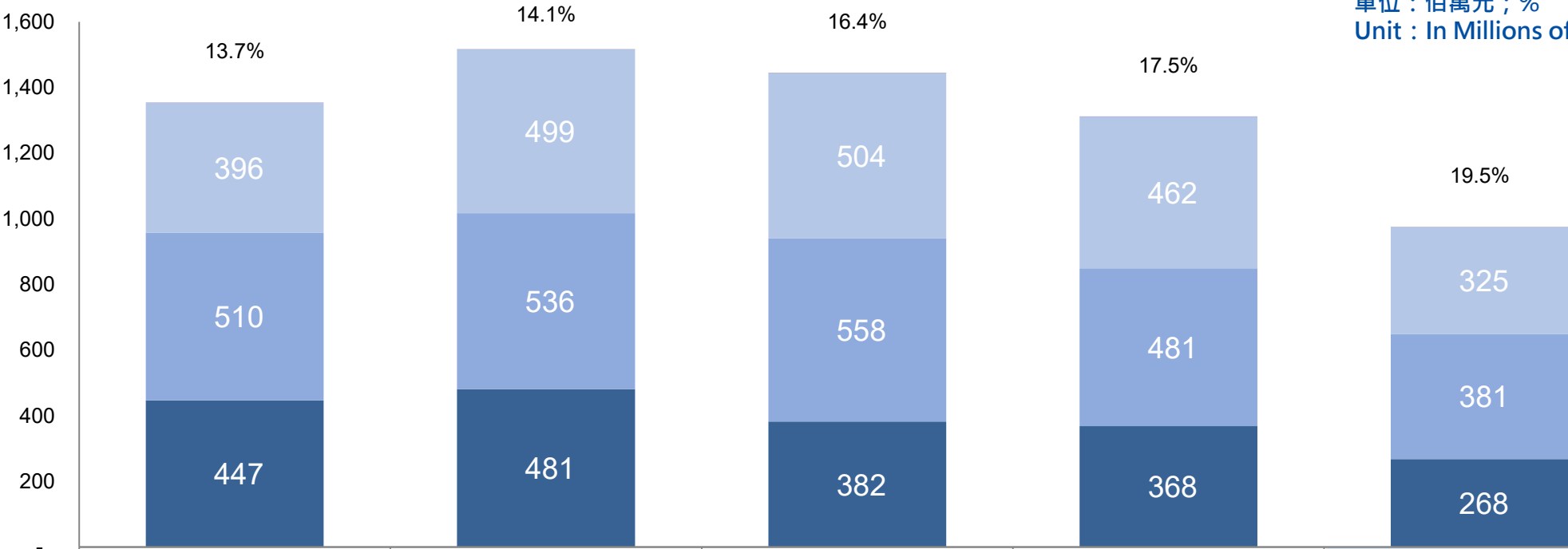
- 半導體自動化系統成為營收主軸，與客戶展開更多層面的自動化系統開發(47%)
- 成為封裝測試廠、載板廠自動化系統的主要供應商

2025年

- 擴大半導體後段製程及相關供應鏈實績獲得前段製程客戶訂單
- 2025年主要營收分別來自封裝測試、載板及前段晶圓廠物流系統。
- 因國際關稅議題使得智能自動化系統全年營收未如預期，預計2026年可重返成長趨勢。

營業費用 Operating Expenses

單位：佰萬元；%
Unit：In Millions of NTD · %



	2021	2022	2023	2024	2025 Q3
■ 佔營收比	13.7%	14.1%	16.4%	17.5%	19.5%
■ 研發費用 R&D	396	499	504	462	325
■ 管理費用 General & administrative	510	536	558	481	381
■ 銷售費用 Sales & marketing	447	481	382	368	268

綜合損益表 Statements of Comprehensive Income

單位：仟元；%

Unit：In Thousands of NTD · %

	3Q/2025	2Q/2025	3Q/2024	季變化	年變化
營業收入淨額 Net Revenue	1,627,461	1,635,965	2,185,324	-0.5%	-25.5%
營業毛利率 Gross Margin	18.7%	20.9%	20.4%	-2.2%	-1.7%
營業費用 Operating Expense	343,118	341,743	385,212	0.4%	-10.9%
營業費用率 Operating Expense Ratio	21.1%	20.9%	17.6%	0.2%	3.5%
營業淨利 Operating Margin	(39,620)	2,731	60,492	-1550.8%	-165.5%
營業淨利率 Operating Margin	-2.4%	0.2%	2.8%	-2.6%	-5.2%
營業外收入及支出 Non-Operating Items	30,237	(164,818)	(42,464)	118.3%	171.2%
本期淨利 Net Income	1,628	(120,811)	21,501	101.3%	-92.4%
每股盈餘 (元) EPS(NT Dollar)	0.01	(0.60)	0.10	0.61	(0.09)

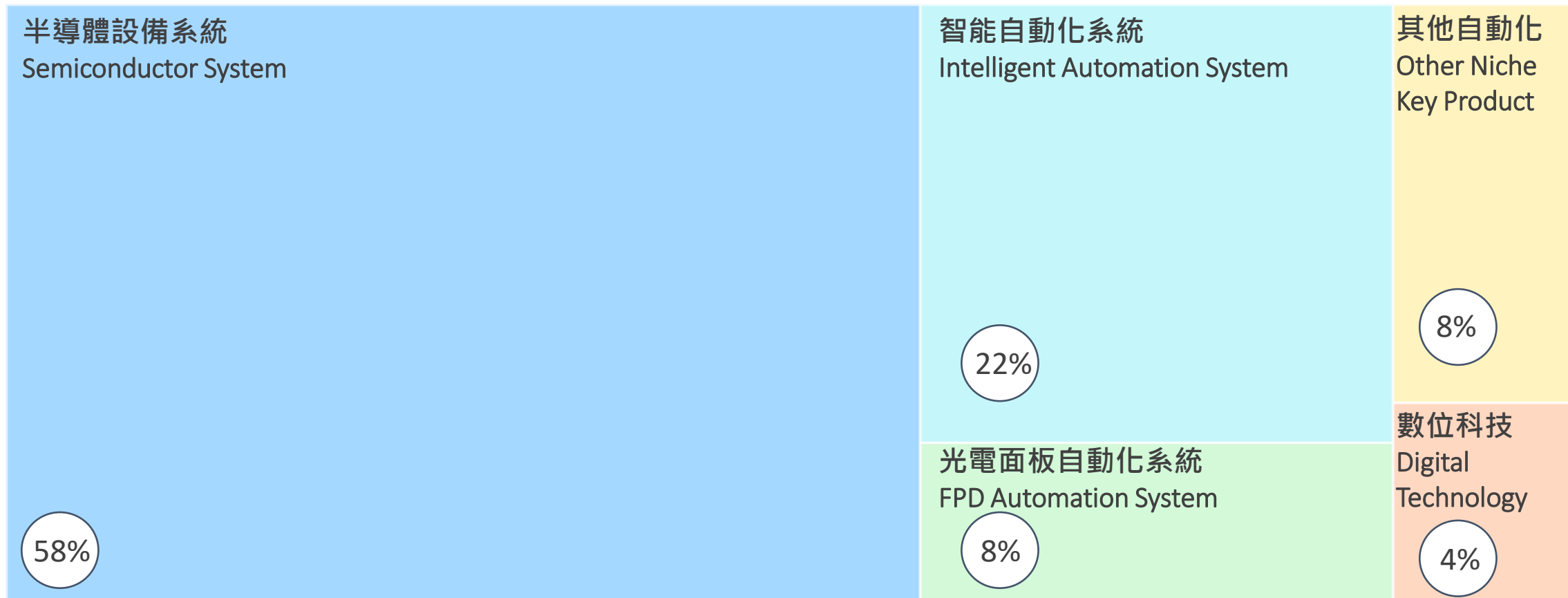
03

營運展望 Business Outlook



Intelligent Automation Leader

在手訂單 Order in Hand



2025年BB ratio >1，顯示上半年市場的不確定性逐漸消散，客戶資本投資需求逐漸回升。

2026 年產能目標

+40%

2026 整體產能擴增30%~40%

藉由全球生產基地及健全供應鏈，快速回應客戶需求。

+30%

半導體高端設備產能

500 台/年

機器人/機器狗及關節模組供應鏈產能

具韌性的供應鏈體系



數位化
Digitalized



可追溯
Traceable



可預警
Predictable

2026關鍵設備產能目標 (Base Line)

OHT 空中走行式無人搬運車	100台 / 月	
EFEM 高速晶送設備	300 台 / 年	半導體/載板關鍵設備
Semiconductor Stocker	300 台 / 年	月產能約 20~30 台
AMR/AGV 無人搬運車	200 台 / 年	自動化物流核心設備

快速擴充優勢：推動產能未來3~5年內增長3~5倍

強大的供應鏈系統支持產能擴充，確保在市場需求增長時能夠迅速回應穩定品質的產能

營運展望 Business Outlook



半導體

- 掌握高端封裝趨勢：

AI 算力需求強勁成長，全球正從單一GPU邁向 GPU × TPU / ASIC 多核架構，帶動 CoWoS、CoPoS、CoWoP與 FOPLP 等先進封裝產能快速擴張，也大幅推升對高潔淨、高彈性自動化搬運的需求。

盟立近年成功轉型，半導體已成營收主力。我們推出的 OHT 空中搬運、Stocker 倉儲、300mm晶圓 / ABF載板 / FOPLP EFEM 與 Panel Handling解決方案，能完整支援 CoWoS、CoPoS、CoWoP 等先進封裝所需的多尺寸載具、高潔淨度與高彈性搬運能力與製程需求。新一代共軌OHT 可支援 12 ~ 40kg 各式載具，協助客戶在封裝規格頻繁變動下快速換線並降低 CapEx；搭配 模組化平台與 AI / 數位孿生維護，大幅提升稼動效率。

對 2026 年展望正向，除持續受惠先進封裝擴產外，已取得 FOPLP整廠自動化專案，可望成為明年首季成長動能。

- 東南亞市場需求上升：

東南亞（馬來西亞、新加坡、泰國）半導體客戶案件推動順暢，規劃中之案件預計 2026 年第二季取得訂單並陸續出貨。

- 營收佔比持續創高：

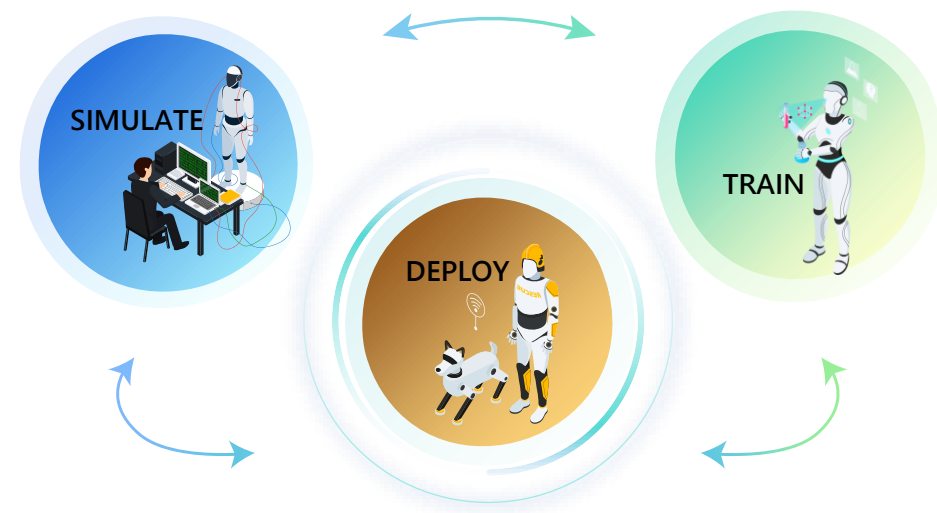
2026 年半導體設備系統合併營收比重可望達到 60% 以上。

營運展望 Business Outlook



AI機器人/機器狗

- AI機器人及機器狗作為AI落地的關鍵載具，藉由AI模型訓練，成功達成『虛擬轉真實（Sim to Real）』的目標。
- 根據半導體、物流及製造業客戶的實際場域情況和需求，訂定AI人形機器人與機器狗的規格及功能。盟立結合集團力量，推動本體的開發。AI機器人及機器狗的本體開發已於2025年第三季完成，預計將於2026年第1季推進實體場域的應用與實測。
- 預估2026年第1季開始出貨



營運展望 Business Outlook

回應客戶專用場域需求，取得並掌握AI機器人公司技術與產品供應能力

實現場域部署預演×成本精算×績效模擬

- 投資設立「應用智能科技股份有限公司APPLIED AI CORPORATION LTD」

致力成為「數位孿生場域建構」與「AI 機器人場域訓練應用」的領導者，不限於運用 NVIDIA Omniverse 等先進平台，將虛擬模擬與 AI 深度結合，實現由虛擬場域走向真實場域的導入流程，開創 AI 機器人自動化應用的新一波革新。

- 投資鞍新盟機器人製造股份有限公司
前瞻布局未來 AI 人形機器人及機器狗的生產技術、關鍵零組件與製造供應鏈體系。



營運展望 Business Outlook

智能自動化物流

- 美國關稅政策影響趨於明朗，客戶已陸續確立投資設廠決策，預期2025年因不確定因素而延宕的自動化系統案件將逐漸回溫，為2026年挹注營運動能。
- 目前客戶已實際提出需求的資本投資計劃相較於2025年更為明確，樂觀看待2026年的接單能量。
- 目前來自北美、歐洲及東南亞的需求已逐漸確定，近日已承接EMS客戶北美廠自動化系統訂單，2026年出貨。





Q&A